

敘豐企業股份有限公司 (3485)

上櫃前業績發表會



風險事項

一、產業風險

本公司主要從事從事印刷電路板(PCB)及IC載板等相關溼製程設備，另有貼合設備及自動化設備等產品。目前以IC載板製程設備等相關應用為主要銷售客戶，若在產業景氣不佳影響之下，客戶將減少資本支出，相關設備需求因而下降，因此，就市場需求面觀之，確有受產業景氣循環影響。

因應對策：本公司積極因應產業趨勢發展，積極研發最新高階載板濕製程技術，拓展新的應用領域。目前持續積極參與客戶在新的製程需求或特殊應用，以強化跨領域產品，避免受到景氣循環波動之影響。

二、營運風險

本公司112~114年度外幣兌換淨損失分別占營業收入及稅前利益之比重為(1.19%)、8.29%、(6.60%)及(2.60%)、16.27%、(14.22%)，因本公司外幣銷售金額均大於外幣採購金額，故累積美元存款，因美元對新臺幣匯率波動致產生匯兌利益，故112~114年度美元對新臺幣匯率變動則對本公司尚有一定程度之影響。

因應對策：本公司財務部門與金融機構保持密切關係，持續觀察及隨時掌握匯率變動，在現貨市場靈活調節外幣部位外，必要時視外匯收支與外匯市場變化進行外匯避險商品操作，以規避匯兌風險。除此，本公司業務單位向客戶報價時，報價決策納入匯率走勢的動態調整報價，以避免匯率波動對獲利產生重大影響。。

風險事項

三、其他重要風險

本公司其他重要風險請詳公開說明書：壹、二，風險事項之說明。

四、補充揭露事項

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項：

(一)風險事項：

- 1.貴公司主要聚焦於IC載板濕製程設備之開發及銷售，且銷貨集中於少數關鍵客戶，112~113年度及114年前三季對欣興集團及長安科技集團合計之銷貨比重分別為94.05%、99.56%及96.52%，有關貴公司銷貨集中之原因、面臨之風險及所採具體因應措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。
- 2.面臨高階載板製程快速演進可能導致既有設備技術世代遭替代之風險，有關貴公司未來研發產品之布局、市場性及開發時程，暨研發人員適足性及如何持續提升研發能量之說明，暨推薦證券商之評估意見。

(二)特別記載事項：

- 1.有關貴公司業績變化合理性及未來發展性之說明，暨推薦證券商之評估意見。
- 2.有關貴公司專利布局策略、關鍵製程及營業秘密保護具體措施之說明，暨推薦證券商之評估意見。

相關說明請參閱公開資訊觀測站之現金增資發行新股申報用之公開說明書稿本。

免責聲明

- 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在與未來營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部分將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性結論大為不同。
- 所提供之資訊（包括對外來的看法）並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。



公司簡介
經營理念



經營實績
財務概況



產品概述
競爭優勢



研發計畫
未來展望



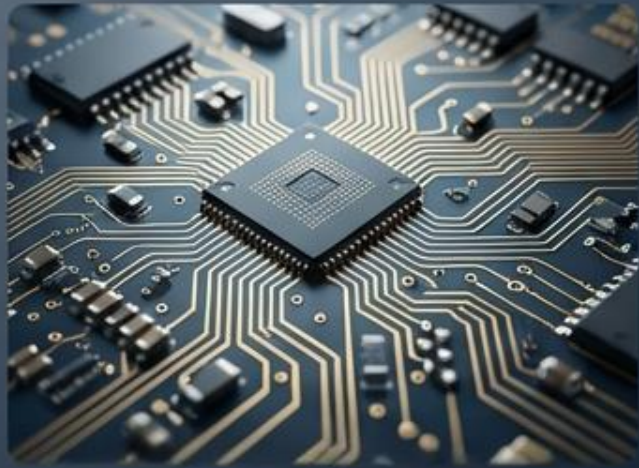
產業走勢



永續發展

三十年穩健深耕，驅動高階製程設備創新

敘豐企業成立於 1994 年，致力於成為高階製程設備的領導品牌。
我們透過三大營運支柱，持續為客戶與股東創造價值：



基礎穩固 | 專精製程設備
專注於印刷電路板 (PCB)、液晶顯示器 (LCD) 及觸控面板 (Touch Panel) 製程設備之研發、製造與整合。



產能後盾 | 完善服務體系
2012年設立昆山廠，強化製造產能與海外售後支援體系，提供客戶即時技術服務。



未來動能 | 跨足先進封裝
積極投入先進封裝 (FC-BGA) 製程設備開發，全力拓展高階載板製程設備市場。

企業進化軌跡與里程碑

股票代號 3485

公司資本額：3億4仟萬元

員工人數：約99人（精實高效團隊）

（截至115.02.28日止）

1994

敘豐企業股份有限公司成立

2000

敘豐新廠（現址）落成啟用
取得 ISO-9001 品質認證

2002

取得 ISO-9001
2000年版品質認證

2005

股票公開發行

2012

昆山新廠落成（第一期）
正式登錄興櫃（股票代號：3485）

2015

合併台灣歐特瑪科技
股份有限公司

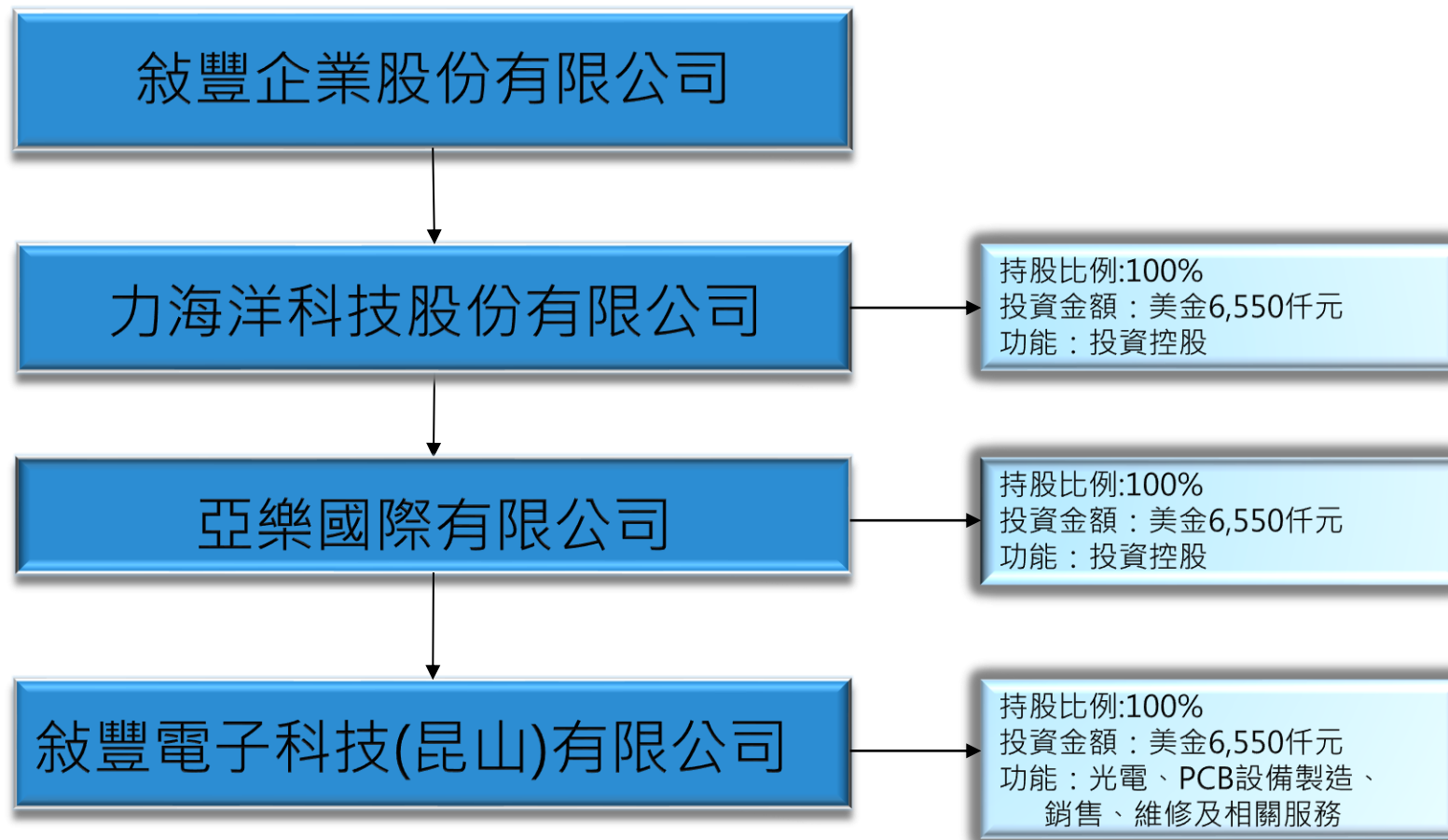
2017

取得 ISO-9001
2015年版品質認證

2020

昆山廠
二期廠房完工

集團轉投資架構





- 1.大陸廠位於江蘇省昆山市
- 2.建廠完成: 2012年 5月(第一期)
2020年12月(第二期)
- 3.土地面積: 26,666.7m²
- 4.廠房面積: 22,418.56 m²

- 1.台灣廠位於桃園市八德區
- 2.建廠完成: 2000年1月
- 3.廠房面積: 8,200 m²
850 m²無塵室(Class10,000)
2,500 m²潔淨室

董事會結構：具備財務、產業與法律之多元專業

股票代號 3485

董事長 & 一般董事

周政均 | 董事長

艾瑪投資(股)公司董事長
兆陽投資(股)公司董事
敘豐企業(股)公司董事長特助、執行副總

珮瑜投資(股)公司 | 法人董事

詹珮琳 | 法人董事代表人

珮瑜投資(股)公司董事長、瑜珮(股)公司
董事長、昱銘公司財務科長

帛億(股)公司 | 法人董事

陳怡君 | 法人董事代表人

帛億(股)公司董事長、威賜整合行銷
執行秘書

獨立董事

劉東杰 | 獨立董事

台灣中小企銀31年資歷，
曾任國際部經理
(財務 / 金融專業)

周斌 | 獨立董事

台灣中小企銀35年資歷，
曾任洛杉磯 / 中壢分行經理
(財務 / 跨國金融專業)

張裕倉 | 獨立董事

財團法人台灣產業服務基金會顧問
、台灣綠色生產基金會部門經理
(產業發展與永續專業)

陳韻如 | 獨立董事

翊捷法律事務所主持律師
(法律 / 合規專業)

公司經營團隊

 股票代號 3485

具備電子設備產業相關資歷與專業設備製造管理經驗

執行長 / 周政均 / 99.11.14
敘豐企業(股)公司執行副總、
敘豐企業(股)公司董事長特助

業務部副處長 / 高國洲 / 112.04.06
台灣三墾電氣股份有限公司主任
敘豐企業股份有限公司業務部經理

總經理 / 杜松穎 / 97.03.03
敘豐企業(股)公司副總經理
台灣歐特瑪科技股份有限公司副總經理

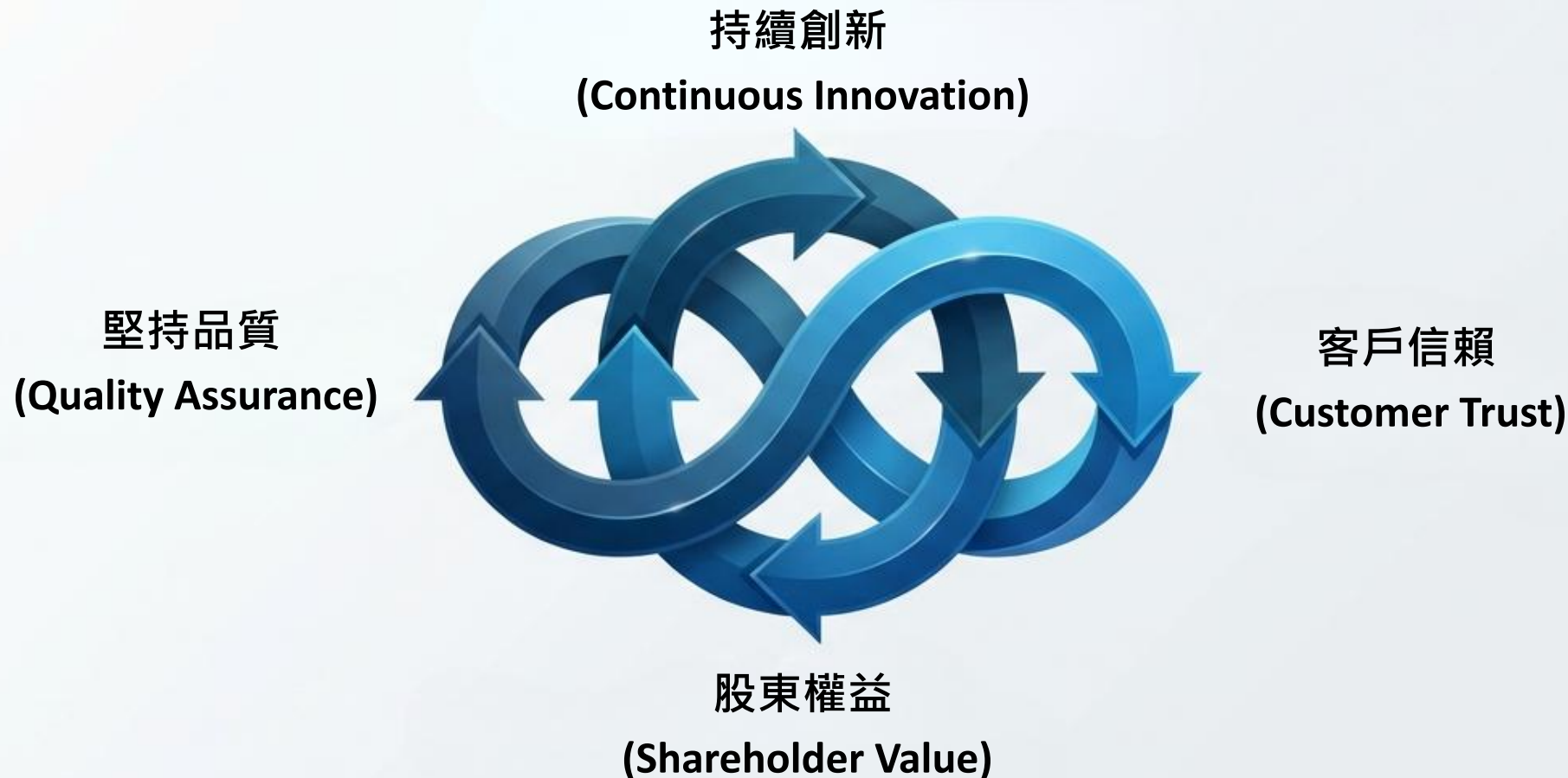
製造部兼廠務部副處長 / 黃勝衍 / 111.05.09
能電電氣股份有限公司經理、
捷嘉自動化股份有限公司負責人

生產製造處兼品保部協理 / 鄭材治 / 109.02.03
中華映管股份有限公司營運處總處長

研發部副處長 / 羅德強 / 93.05.17
台灣歐特瑪科技股份有限公司研發部經理

經營理念：驅動企業成長的循環

我們堅信，透過持續創新與品質管理，能建立長期的客戶關係，進而保障全體股東的最大利益





公司簡介
經營理念



經營實績
財務概況



產品概述
競爭優勢



研發計畫
未來展望



產業走勢



永續發展

四大核心設備

構築智穩健成長基石



高階載板 FC-BGA 設備

核心應用

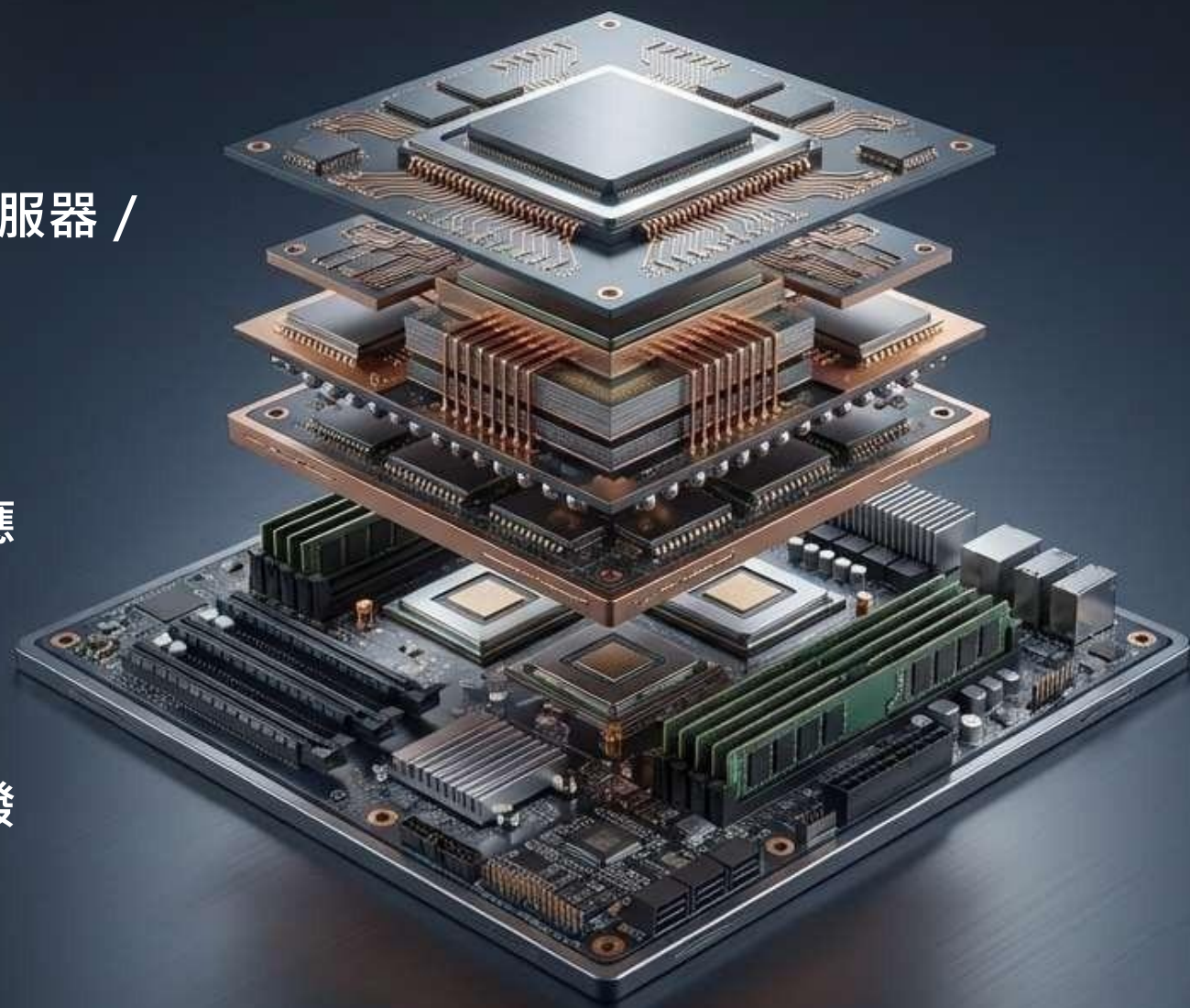
高階 IC 載板、先進封裝應用，以及 AI 伺服器 / HPC 載板。

市場定位

作為高階封裝製程設備供應商，專精對應高密度、高層數的製程需求。

發展契機

設備開發方向配合當前先進封裝的強勁發展趨勢。



FCBGA(SAP)

股票代號 3485

Dielectric Lamination

Via Drilling

Seed Layer Deposition

Lithography Precleaner

Exposure

Lithography Developer

Electric Cu

Stripper

Flash Etching

Roughening

Solder Mask Developer

OSP



Lithography Precleaner

前處理



Lithography Developer

黃光顯影



Stripper

剝膜



Flash Etching

快速蝕刻



Roughening

MEC CZ8101/8201/8401



Roughening

VSP-四國化成工業GliCAP
台灣/日本/中國/韓國專利申請中



Solder Mask Developer

SM顯影



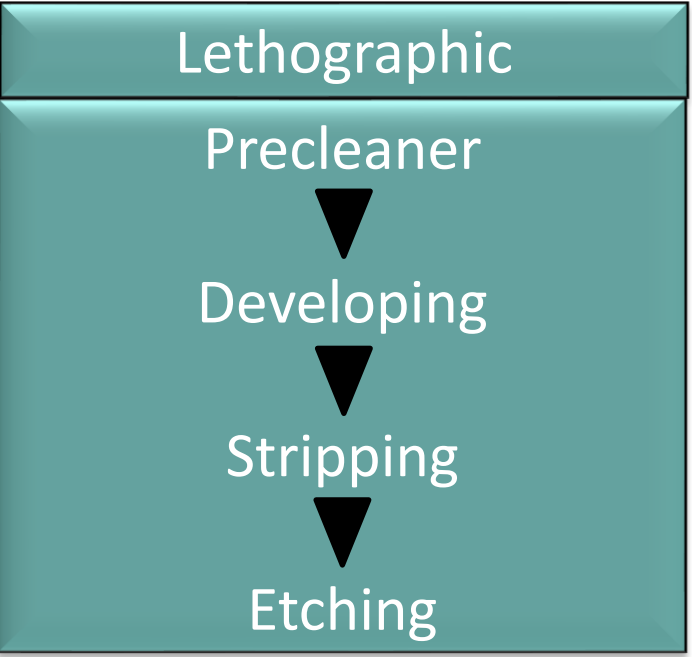
OSP

有機助焊保護層

TGV Module

TGV Formation Glass Hole

TGV Seed Layer Formation



Precleaner

前處理



Developing

顯影



Stripping

有機鹼剝膜線(需防爆消防系統)



Etching

銅鈦蝕刻

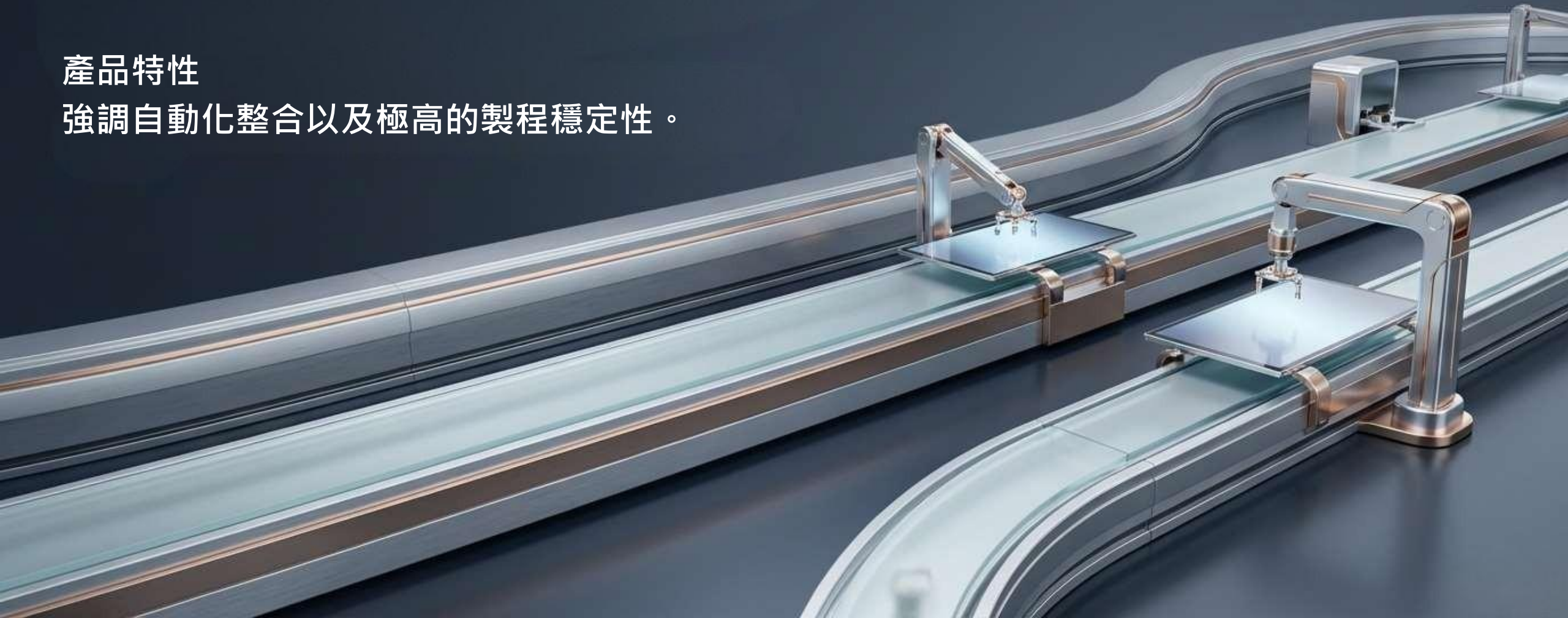
顯示器生產設備：極致穩定的製程設備

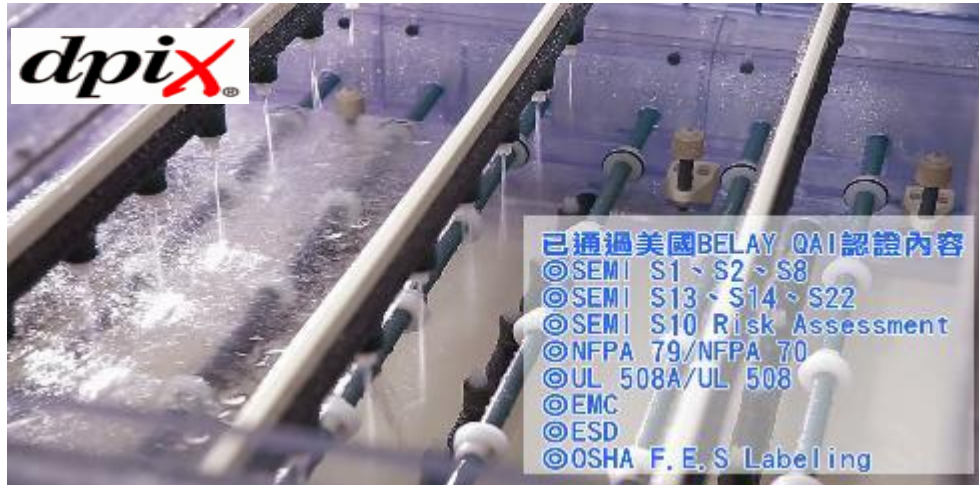
應用領域

LCD 製程設備、觸控面板生產線設備、柔性顯示模組相關製程。

產品特性

強調自動化整合以及極高的製程穩定性。





X光感測器4合1蝕刻線



玻璃捲對捲清洗線



柔性觸控捲對捲 D-E-E-S線



AMOLED清洗線

智慧自動化設備：全方位提升產線良率與效率

應用功能

智能產線整合、製程自動化串接。

核心優勢

取代人類復雜動作與感知，降低人員碰觸基板造成良率風險，強化智慧製造的整體能力。



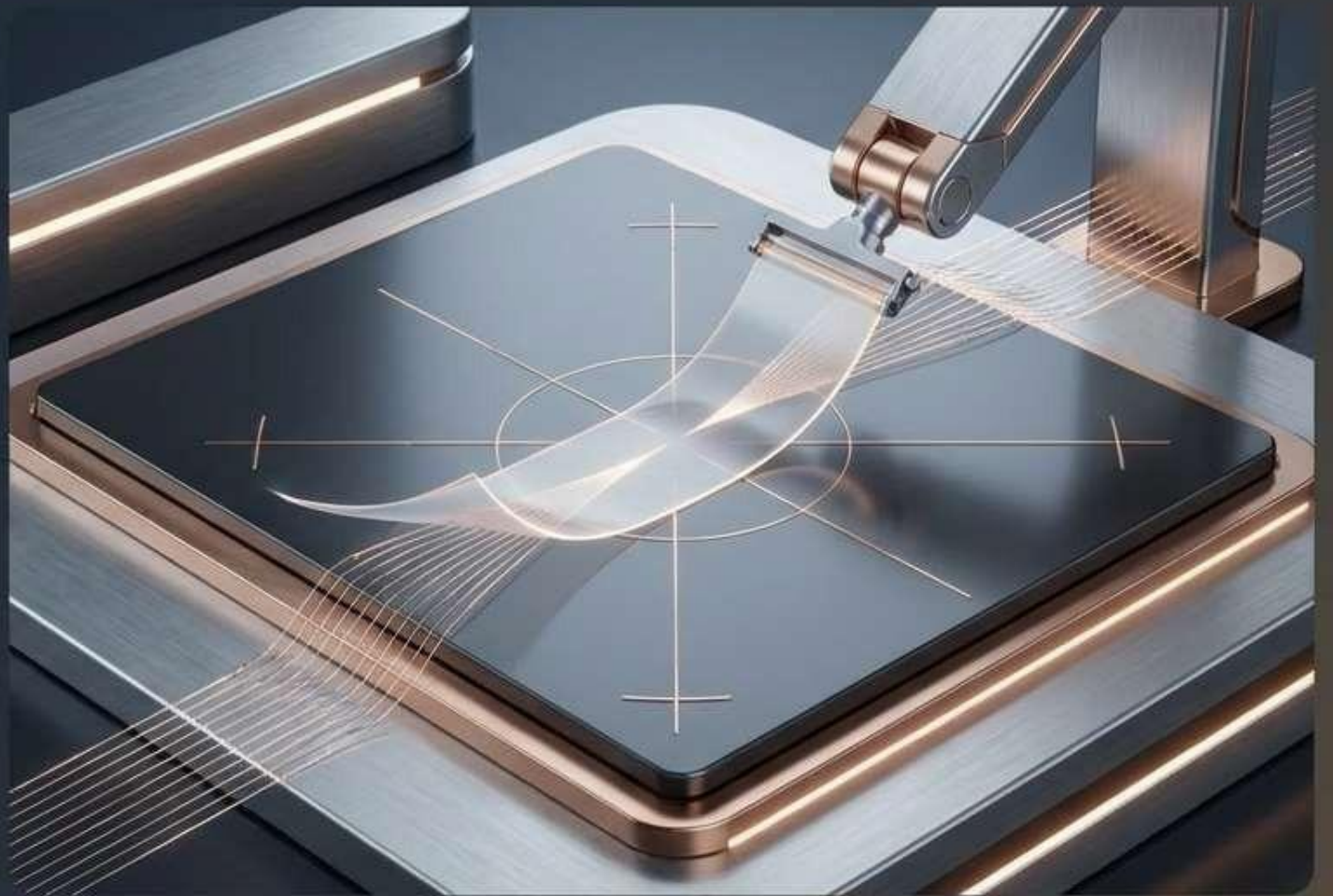
離型取下及貼合設備：柔性膜材的精密剝離與貼附技術

應用範圍

柔性顯示器、貼合製程、精密剝離與貼附技術。

技術特性

主要技術為精密對位與應力控制，適用於柔性顯示器與高階載板內嵌被動元件製程應用。



建立高階製程的四大核心技術



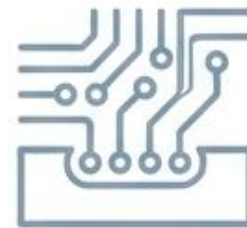
洗淨技術
極致的表面淨化能力



潔淨技術
無妥協的環境控制



微影能力
高縱深比的精準顯影



蝕刻能力
微細線路的完美重現

樹立高階濕製程設備的新標竿

洗淨技術

極致的表面淨化精準鎖定微污染源
，提供完美的基板淨化方案。

- 針對殘留離子、微小粒子及殘膠污染進行深度清洗。
- 顯著提高基板潔淨度，並確保板面品質的絕對穩定。



CLASS 100 高潔淨腔體設計

以嚴苛標準打造半導體等級的生產環境

- 腔體與傳動分離設計

有效隔離設備傳動機構所產生的粒子污染，
並搭配水潤設計避免微粒逸散，確保腔體潔淨度。

- 0.02 μm 半導體級濾芯

有效攔截微粒污染，確保 CDA (潔淨乾燥空氣) 品質，
從源頭避免腔體二次污染。

高潔淨流體與氣體系統

- SUS 配管內電解處理

透過電解拋光處理，去除管內有機物與微粒，
有效降低化學液體與氣體系統污染。

- 鐵氟龍風刀配管設計

採用鐵氟龍 (PTFE) 材質風刀與配管，
降低粒子附著與脫落風險，維持製程潔淨度。



支援先進封裝與高階載板製程，滿足 FC-BGA、TGV 等高潔淨製程需求

微影能力

專注高縱深比微細線路顯影
關鍵顯影技術

動態均勻噴灑技術

採用高速擺動噴灑系統，搭配分段式精密壓力調整與穩壓控制機構使顯影藥液衝擊力均勻分布於基板表面，確保高精度線路顯影品質。

透過二次修整顯影機制

利用高壓空氣將藥液微粒化並提升衝擊能量，有效強化細線路顯影能力，大幅提升高密度微細線路解析度。



支援高階載板（FC-BGA）與高密度封裝製程所需之微細線路製作能力。

蝕刻能力

實現微細線路的高精準度

- **精密流體控制：**
蝕刻液噴灑採用快速擺動，搭配分段精密壓力調整及穩壓系統，確保藥液衝擊力與蝕刻均勻性。
- **藥液濃度管理：**
導入精確的藥液濃度管理系統，顯著提升蝕刻均勻性。
- **最終成果：**
確保微細線路圖形的絕對再現性與最高蝕刻精度。



公司產品的銷售區域大部分為台灣，大陸、日本、韓國，故公司專利佈局皆以台灣、大陸、日本、韓國為主。而專利申請內容是以關鍵技術上下連結機構加上相類似關連型態所組成專利範圍。

115年2月底(有效專利)						
地區	台灣	大陸	日本	韓國	美國	合計
專利數	17件	15件	13件	3件	2件	50件



公司簡介
經營理念



經營實績
財務概況



產品概述
競爭優勢



研發計畫
未來展望



產業走勢



永續發展

AI 成為市場強勁動能

市場分化

通用伺服器與 PC 訂單略低於預期。



強勢增長

生成式 AI 伺服器與 HPC (高速運算) 載板訂單遠超預期。



核心結論 :AI 高算力需求已正式成為高階載板市場的主要成長動能。

2026 AI 需求增 高階 ABF 載板需求急增

產能滿載

IC 載板龍頭廠預測：現階段產能幾乎被訂滿。客戶擔心未來 2-3 年產能供應吃緊，已提前洽談中期計畫。

供不應求

市場預測，高階 ABF 載板於 2026 年將出現供不應求狀況。

資本支出

IC 載板廠持續擴大資本支出
欣興 2026 年上調至 254 億元。
景碩未來 3 年投資 236 億元。
臻鼎未來 2 年上調至 1000 億元。

先進 IC 載板市場穩健擴張

根據 Verified Market Research (VMR) 報告：

全球先進 IC 載板市場將由 2024 年的 87.8 億美元
，成長至 2031 年的約 138 億美元。年複合成長率
(CAGR) 達 6.67%。

成長動能：

AI 高運算需求、先進封裝技術發展、
載板廠擴產與資本支出增加。



AI 基礎建設的十年高成長期

根據 MRFR 研究預估：

全球 AI 伺服器市場規模將從 2025 年的 320 億美元，增加至 2034 年的約 4,580 億美元。此數據顯示 AI 基礎設施需求將持續攀升，帶動伺服器載板與高階封裝需求呈現倍數級擴大。





公司簡介
經營理念



經營實績
財務概況



產品概述
競爭優勢



研發計畫
未來展望



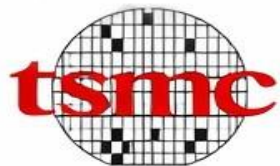
產業走勢



永續發展

主要銷貨客戶群

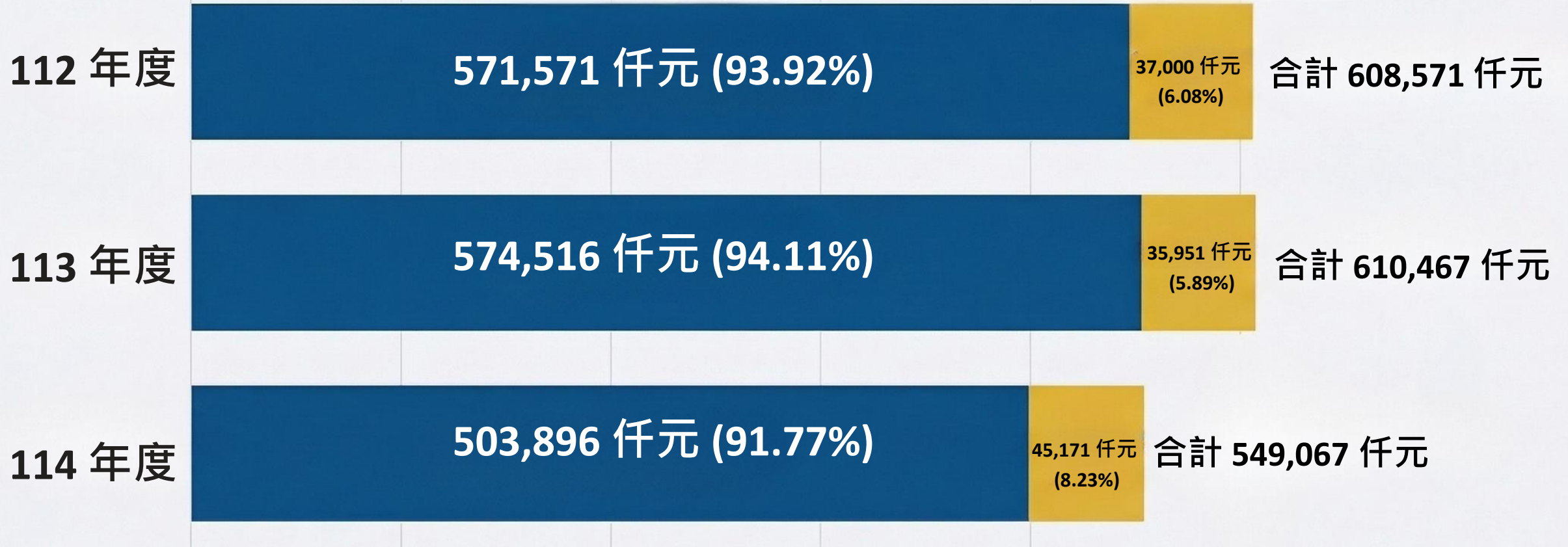
Unimicron
欣興電子



伯恩光学

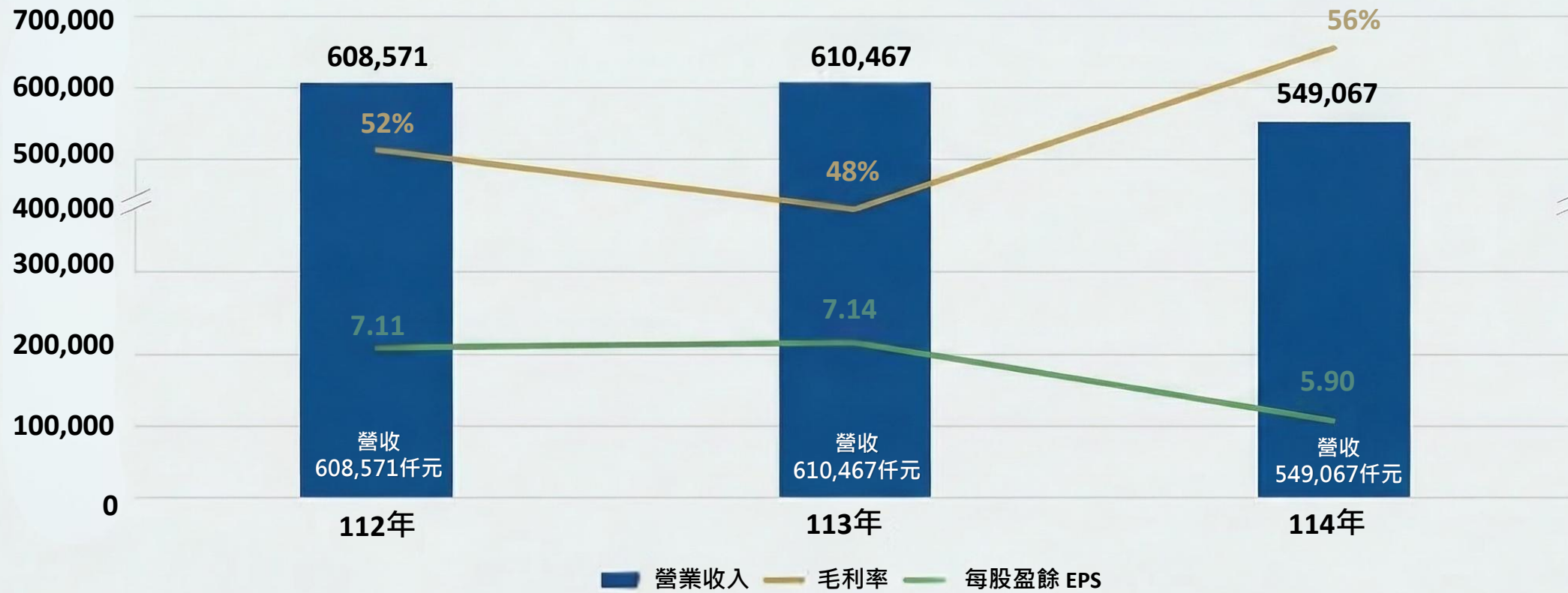


高階 FCBGA 設備貢獻逾 90% 穩定營收



高階 FCBGA 設備銷售維持 90% 以上佔比，為營運最穩固基石

穩定營收基礎下的獲利結構優化



連續3年配息成長



股利政策特性：

- 1、2025年現金股利達 5.5 元，為近年新高。
- 2、股東回饋率穩定，股利發放率維持70%水準
“實踐對股東的實質回饋”。



公司簡介
經營理念



經營實績
財務概況



產品概述
競爭優勢



研發計畫
未來展望



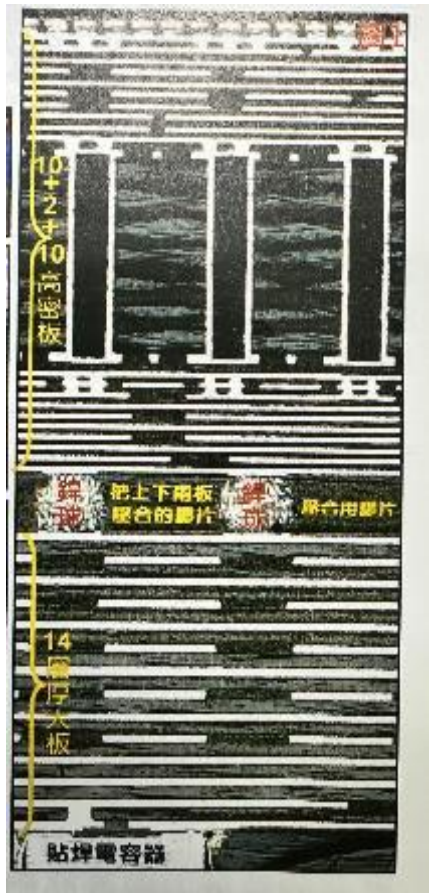
產業走勢



永續發展

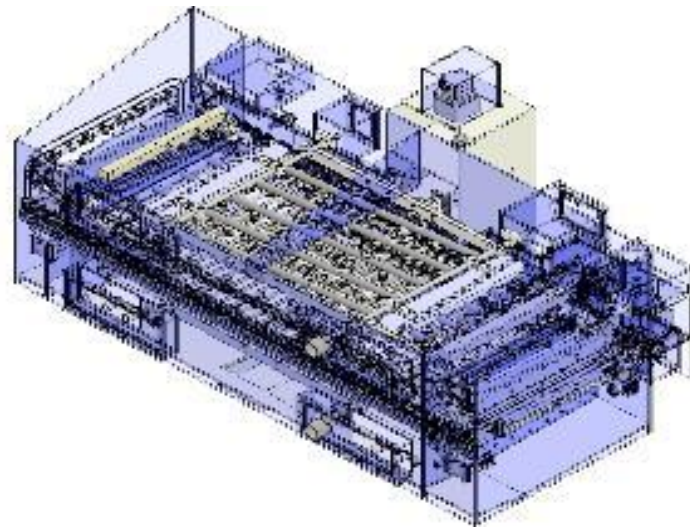
研發計畫

OAM模組生產設備



厚大複合板截面

資料來源:TPCA



— 產業背景：

OAM (Open Accelerator Module) 為AI伺服器設計的硬體架構，旨在實現 GPU 之間、以及 GPU 與 CPU 之間的超高頻寬與低延遲連接。

— 製程挑戰：

OAM 載板的尺寸與厚度顯著大於傳統 FCBGA 載板。

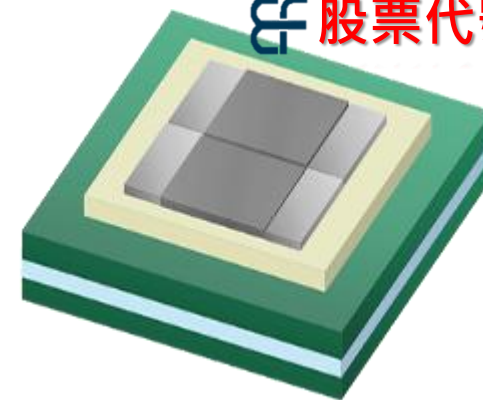
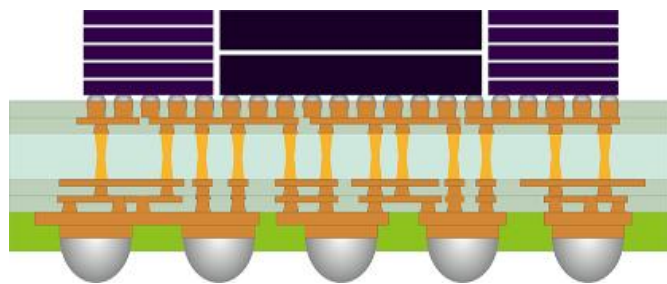
— 技術突破：

成功開發專門對應此類厚大複合板的「水平生產設備」，突破尺寸限制。

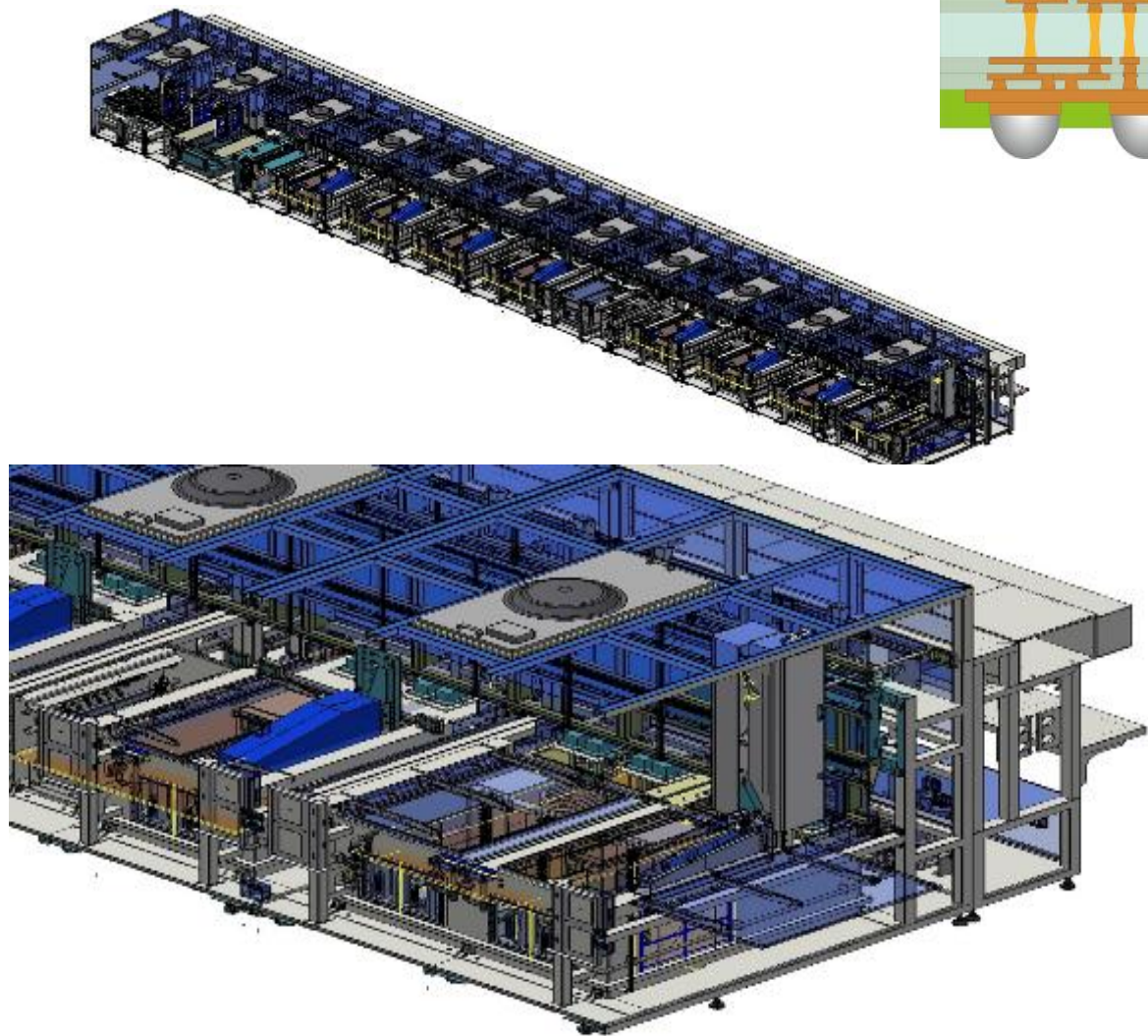
研發計畫

VSP-複合蝕刻機

股票代號 3485



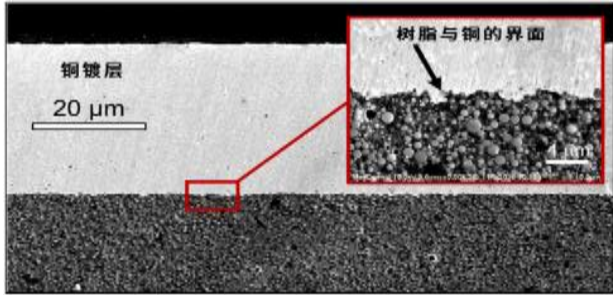
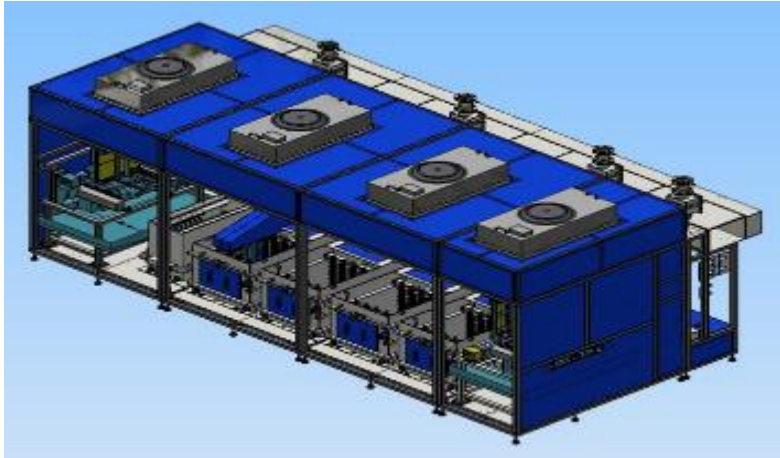
FC-BGA基板玻璃芯 資料來源TOPPAN



- 製程痛點：
TGV (Through Glass Via) 玻璃製程中，不同的線路層材質需要使用不同的蝕刻線。
- 創新整合：
針對不同材料的蝕刻需求，將多種蝕刻液整合於「同一生產線」內。
- 效益：
徹底免除建置多條獨立生產線的需求，大幅優化空間與生產效率。

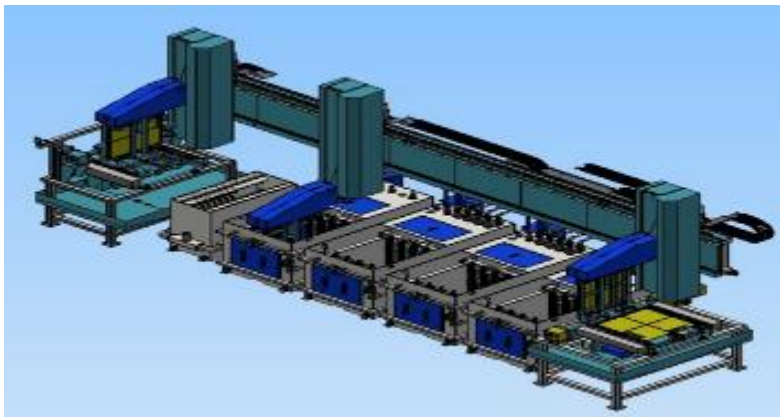
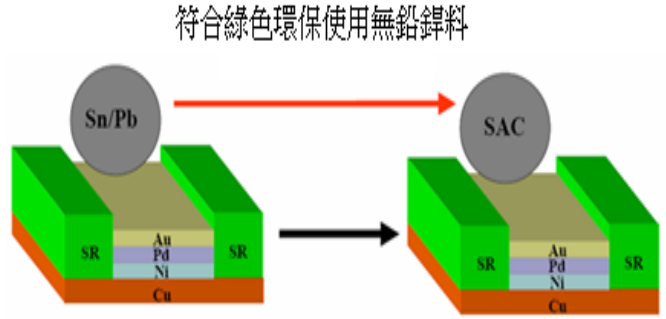
研發計畫

VSP-鎳鈀金製程設備，化學銅沉積製程設備



對於半加晶種層的性能而言
樹脂和銅界面的銅層附著力是
至關重要的指標

載板使用化學鎳鈀金為表面處理的背景



跨領域合作，佈局次世代表面處理設備

VSP 設備優勢：
以VSP設備能有效縮減製程設備長度、寬度及設備高潔淨度的核
心優勢，與客戶、特用化學品商合作開發跨領域市場。

短長期計畫

長期

- 開發完整VSP產品線，增加產品製程應用領域
- 藉由策略聯盟、國際技術合作掌握市場先機

短期

- 以利基指標產品積極開拓新客戶
- 提升研發技術及能量投入下一代高階生產設備



公司簡介
經營理念



經營實績
財務概況



產品概述
競爭優勢



研發計畫
未來展望



產業走勢



永續發展

永續發展- 環境保護Environmental

產品生命週期

以產品生命週期的角度，
評估降低產品生產運轉
過程中對環境的衝擊

- 一.導入低耗能零件
- 二.節能設計

溫室氣體盤查

秉持「永續共生」的
理念從根本降低碳排
放減少對環境的負擔

能源管理

從源頭減量、廢棄物
再利用到資源回收的
各個環節，持續提升
資源使用效率

- 一.溫調控制
- 二.節省用紙
- 三.節約用水



永續發展- 社會責任Social

友善職場

本公司致力打造安全、尊重且具成長性的友善職場環境，促進員工身心健康與專業發展。



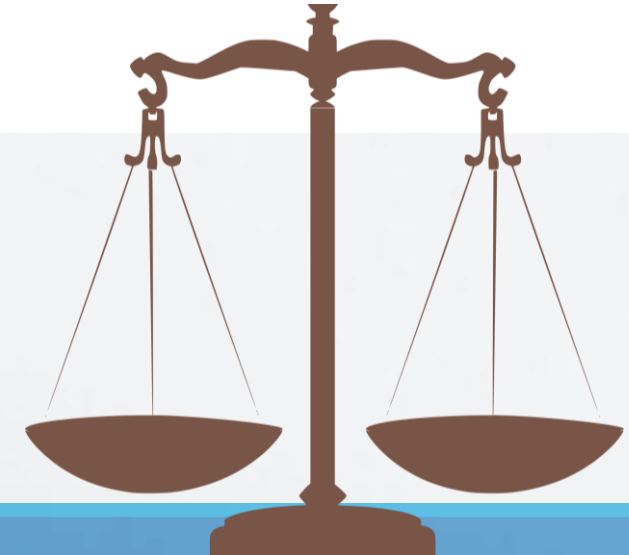
公益福利

本公司積極投入公益活動，以行動回饋社會，支持多元社會議題並擴大企業正面影響力。



人權政策

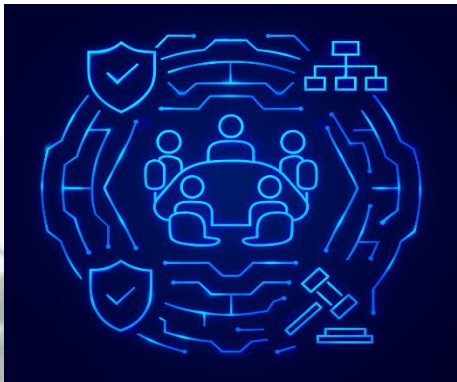
本公司以尊重人權為基本原則，遵循國際準則保障員工與利害關係人之權益，確保營運過程的公平與正直。



永續發展- 公司治理 Governance

董事多元且獨立

- ★設有四席獨立董事，(獨立)董事持續參加進修課程
- ★董事具多元性，有財金、產業及法律的專業人才，給予客觀建議



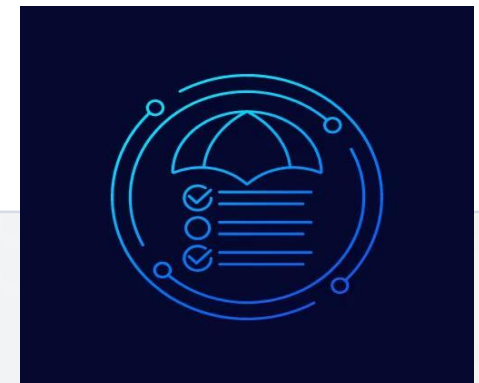
落實誠信經營管理

- ★制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」
- ★定期評鑑往來對象，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易



風險管理

- ★訂定「防範內線交易之管理」及「內部重大資訊處理作業程序」
- ★訂定「風險管理政策與程序」



整合工藝 驅動未來

謝謝 THE END

